

欢迎参加**第三届半导体行业用陶瓷材料技术研讨会**！参会代表请填写下表回传，并在5个工作日内打款至以下账户。参会代表请于会议前一天携带名片至会场签到并领取资料和参会证，会议及活动期间凭参会证进场，请务必随身佩戴。

会议费用：2800 元/人

费用包括：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿。

（付款后开具增值税普通发票）

收款账户：

户名	山东中粉会展服务有限公司
开户行	中国银行股份有限公司临沂北城支行
帐号	233841636876



会 议 回 执

企业全称（发票名称）*			
通讯地址*			
参会意向（选填项）*	☐ 听会 ☐ 采购（产品名称_____） ☐ 销售（产品名称_____） ☐ 新技术推广（_____） ☐ 投资，融资合作（_____）		
参会人员姓名*	职务	联系方式	E - MAIL
会务费用总额（不含住宿）*	仟 佰 元 整		¥
如需预定会议酒店 住宿请填此项 大床及双床均为团体价348/间 不含早餐 。 报到当天自行办理入住*	是否住宿 ☐ 是 ☐ 否	住宿标准（含早）： ☐ 大床房____间 ☐ 双床房____间	
	会议时间：4月24日签到 4月25日全天会议 会议酒店：苏州 白金汉爵大酒店（相城店） 入住时间：4月24日晚		地址：苏州市相城区相城大道1111号 电话：0512-66837666
联系人：任海鑫 联系方式：18660985530（微信同号） 邮箱：2655502740@qq.com		签字： 日期：	

